

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-11-002

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	会议组织者： 民生证券 参与机构： 易方达基金、南方基金、广发基金、平安基金、银华基金、申万菱信、浙商基金、金鹰基金、宝盈基金、长信基金、华银基金、惠升基金、国泰君安、华融证券、民生证券、国盛证券、太平洋证券、德邦证券、长江资管、南传资管、兴业国信、苏州国信、苏民投、益安资本、肇万资管、浙银首润、德邦资管、中非信银、圆石投资、朱雀股权投资、解惑国际投资、百年资产、华泰保兴、珠江投资、银叶投资、国都资管、金控资产、趣时资产、中科沃土、歌斐资产、鑫湾投资、轻盐创业、中执资本、基明资产、银润资产、瑞民投资、纽富斯投资、光大保德信、富业盛德、博芮投资、睿郡资产、竣弘投资
时间	2021年11月25-26日
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书：蒋威 证券事务代表：王渝
投资者关系活 动主要内容介 绍	本次活动分为现场交流及 IC 封装基板工厂参观两部分。以下为现场交流主要内容： 一、公司简介

公司成立于 1993 年，持续 28 年深耕线路板产业链，从 PCB 样板起家，2012 年开始进入 IC 封装基板领域，2015 年通过收购美国 HARBOR 和设立上海泽丰（现已出表）进入半导体测试板领域。公司重视研发，坚持走技术升级道路，以研发促进产品、技术和应用领域的升级，实现了从传统 PCB 到半导体测试板、IC 封装基板的产品、技术和客户的升级。

公司上市以来收入持续增长，毛利率保持平稳，持续盈利。营收规模由 2010 年的 8.04 亿元稳步增长至 2020 年的 40.35 亿元，十年复合增长率为 17.51%；主营业务平均毛利率为 31.55%，因产品结构、经营模式的差异使公司具备一定的议价能力，毛利率处于同行较高水平；归母净利润由 2010 年 1.21 亿元增长至 2020 年 5.22 亿元，十年复合增长率为 15.70%。基于公司良好的经营状况，公司重视回馈股东，上市以来坚持每年现金分红，十年累计分红 7.09 亿元，十年平均占归母净利润比例为 32.6%。

受益于早年的布局、当前 IC 封装基板全球缺货及下游爆发式增长，公司迎来了良好的发展机遇，未来公司的重点工作是推动广州兴科项目 IC 封装基板业务的投资扩产。

二、公司产能情况介绍

PCB 业务：2020 年度，广州生产基地产能为 33.72 万平方米/年；宜兴生产基地产能为 25.5 万平方米/年；英国 Exception 公司产能为 0.4 万平方米/年；广州生产基地新增中、高端、多层样板产线，规划产能为 1.5 万平方米/月，目前产能处于逐步释放过程中；小批量产线在广州生产基地和宜兴生产基地，此次公司启动的非公开发行项目主要是宜兴生产基地二期工程，建设完成后将新增 96 万平方米/年的量产产能，将分期建设投产。

半导体测试板：经营模式与样板类似，属于多品种、小批量、定制化生产模式，产品单价和附加值较高。主要经营主体有美国 HARBOR、广州科技。HRABOR 从事测试板的设计、生产和贴装，虽然产能少，但单价高。广州科技测试板扩产目标是建设国内最大的专业化测试板工厂，并为美国 Harbor 提供产能支持。

2021 年上半年半导体测试板实现销售收入 2.03 亿元。2021 年上半年测试板收入同比下滑主要是因为出售上海泽丰股权导致其不再纳入

合并报表，美国 Harbor 产能受限，以及国内扩产的半导体测试板产能尚未形成增量贡献。

IC 封装基板：目前广州生产基地 2 万平方米/月的产能已处于满产状态，良率保持在 95%以上；与大基金合作的 IC 封装基板项目（广州兴科）分二期投资，第一期规划的产能为 4.5 万平方米/月，目前已在珠海完成厂房建设，处于装修和产线设备安装阶段。

三、公司优势介绍

28 年的专注与专业化发展，公司摸索形成了与自身业务模式相适应的体系化能力。公司工艺技术领先，柔性化管理能力强，每年 28+万种产品的强大生产能力及平均 7 天的稳定快速交货能力达到先进水平，客户多为下游多个行业领先企业或龙头企业，公司建立辐射全球的服务网络，为客户提供当地化的快捷服务。

自主研发亦是公司发展动力之一，公司平均研发收入占营收比重达 5.7%，随着在建产能逐步投产及工艺提升，公司的产能规模将保持持续增长。多年的技术积累及行业深耕，公司被认定为“国家高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“广东省创新型企业”、“广东省高密度集成电路封装及测试基板企业重点实验室”，且先后组建了 3 个省级研发机构，具备承担国家级政府项目的能力。

此外，公司获取订单能力较强，且不依赖单一客户，客户群体所涉行业较广，受下游客户单一行业周期影响小。

四、IC 封装基板业务介绍

半导体行业从 2020 年开始表现出产销两旺的格局，收入、利润持续增长，产业链景气度高。公司从 2012 年开始进入 IC 封装基板领域，2018 年实现满产，2019 年实现财务层面盈利，预计 2021 年实现预设经营目标。

2020 年全球 IC 封装基板行业规模 100 亿美金，增长 25%；Prismark 预测 2021 年全球 IC 封装基板行业规模达到 120 亿美金，增长接近 20%，2025 年达到 160~170 亿元，复合增长率预期为 9.7%，届时 IC 封装基

板将超过软板成为线路板行业中规模最大、增速最快的细分子行业。2020 年内资载板厂规模为 4 亿元美金，全球市场占有率仅为 4%，而国内封测厂全球市场占有率为 25%以上，国产配套率仅有 10%左右。IC 封装基板和半导体测试板是芯片制造和测试的关键材料，未来国内晶圆和封测产能持续扩产是 IC 封装基板行业需求增长的保证，受益于芯片产业链的高景气，公司目前 IC 封装基板订单能见度高。

IC 封装基板目前国内仅有三家公司具备量产能力和稳定的客户资源，兴森科技就是其中一家，行业赛道好，玩家少。三星认证的通过说明了我们的体系、能力、技术都得到了头部客户的认可，且海外大客户的认证周期都是长达 2 年以上，因此预计未来 2~3 年新进入者仍无法成长到足以与公司比肩，产业链供需格局预期仍乐观。

五、行业发展趋势介绍

目前来看，中国经济已逐步回归正常发展，国内疫情所带来的影响已逐步减弱，带动需求回升、订单增长；世界经济已开始复苏，行业总体是乐观的，但也存在一些不可控因素，如疫情反复、中美贸易战、缺货、原材料涨价等，均会对行业产业链造成一定的冲击。目前全球视野中，马太效应凸显，头部 PCB 企业增长良好；市场结构方面，呈现结构分化的增长趋势：高端产品（IC 封装基板、高多层板、HDI 板）景气度较高，整体呈紧缺态势；低层板市场需求略显疲软。芯片产业链维持高景气度，预测 IC 封装基板至 2025 年，Sip 复合增长率 14.1%，FC BGA 增长 10.8%，FC CSP/BOC 增长 9.0%。

企业未来的增长空间视产品结构及客户结构差异而有所不同，随着公司逐步调整产品结构（扩大高端产品占比），及多行业优质客户的深度绑定，未来增长空间可期。只要继续保持研发和核心技术的领先优势，持续改善良率和交付，随着产能的持续增长，公司有望实现持续稳定发展。

附件清单	无
日期	11 月 26 日